TIF®100-18-11US 系列
导热绝缘片规格书

TIF®100-18-11US 可用于填充发热器件和散热片或金属底座二者之间的空气间隙。该款材料柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。其优异的效能使热量从发热器件或整个PCB传导到金属外壳或散热片上，从而提高发热电子组件的效率和使用寿命。

特性

》良好的热传导率: 1.8 W/mK
》带自粘而无需额外表面粘合剂
》高可压缩性, 适合于低压力应用环境
》可提供多种厚度选择

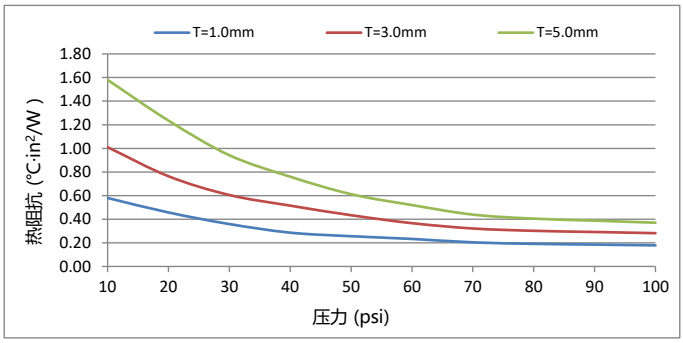
应用

》散热器底部或框架
》显卡模组
》机顶盒
》电源与车用蓄电电池
》LED电视 、灯具

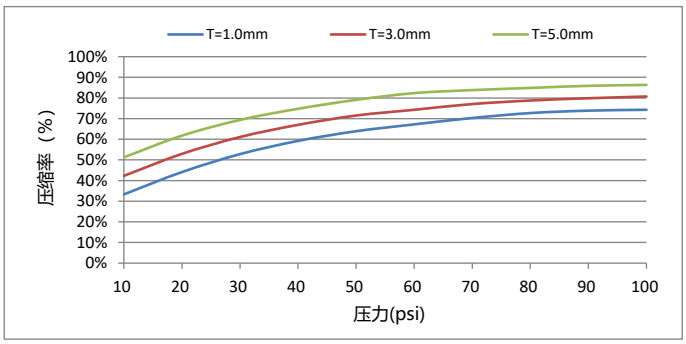
TIF®100-18-11US系列特性表

产品特性	典型值	测试方法
颜色	灰色	目视
结构&成份	陶瓷填充硅橡胶	-
厚度范围 （inch/mm）	0.02~0.20 0.50~5.00	ASTM D374
硬度（Shore OO）	20	ASTM D2240
密度（g/cc）	2.7	ASTM D792
建议使用温度范围（℃）	-45～200	兆科测试
击穿电压（V/mm）	≥5500	ASTM D149
介电常数 @1MHz	4.5	ASTM D150
体积电阻率（Ohm·cm）	≥1.0×10^{12}	ASTM D257
导热系数（W/mK）	1.8	ASTM D5470
	1.8	ISO22007-2
阻燃等级	V-0	UL94（E331100）

热阻抗



压缩率



产品规格

标准厚度: 0.02" (0.50 mm)~0.20" (5.00 mm)，以 0.01" (0.25 mm) 为增量 。

标准尺寸: 16"×16" (406 mm×406 mm)。

零件编码:

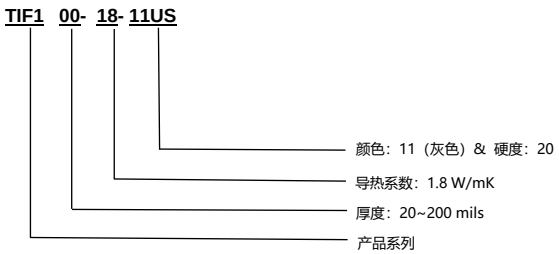
补强载体：FG（玻璃纤维）。

涂层处理：NS1（无粘性涂层）、DC1（单面加硬）。

胶层处理：A1/A2（单面/双面带胶黏剂）。

TIF系列可模切成不同形状提供。如需不同厚度或想了解更多导热材料的产品信息，请与本公司联系 。

产品型号说明



全球方案: 在地服务
中国：+86-769-38801208
台湾：+886-2-2277-1007
加拿大：+001-604-2998559
越南：+84-396852859
service@ziitek.com
www.ziitek.com

Ziitek Technology Ltd(兆科科技有限公司)及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的，产品规格可能因技术改动或优化而调整，恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担，Ziitek(兆科)本公司不对产品的适用性、可销售性或特定用途作任何保证，亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek(兆科)及其标志为公司或关联公司所有。